

华泰联合证券有限责任公司

关于广州慧智微电子股份有限公司

2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：慧智微
保荐代表人姓名：彭海娇	联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：张辉	联系电话：010-56839300

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，对慧智微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2026 年 1-6 月（以下简称“报告期”），公司营业收入为 46,846.48 万元，较上年同期增加 32.14%，归属于上市公司股东的净利润为-13,668.65 万元，净亏损较上年同期增加 109.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,553.71 万元，净亏损较上年同期增加 5.96%。截至 2026 年 6 月 30 日，发行人未分配利润金额为-176,506.87 万元，存在累计未弥补亏损，预计在未来一定期间内未弥补亏损将继续扩大。

2026 年 1-6 月，营业收入实现同比增长、利润表现为亏损状态且净亏损增加的主要原因系：报告期内公司产品结构不断优化，国内头部品牌客户和海外客户出货量稳步提升，推动公司营业收入实现增长；但受累于当期政府补助产生的其他收益减少、资产减值损失等方面的影响，净亏损同比有所增加。因公司仍处于成长阶段，产品销售尚未形成突出的规模效应，同时毛利率仍处于较低水平，销售毛利无法完全覆盖公司研发投入等各项支出，导致公司仍处于亏损状态。

上述问题不涉及整改事项。保荐人及保荐代表人提请公司做好相关信息披露

工作，及时充分地揭示相关风险，同时提醒公司重视上述问题，积极提升产品竞争力、持续开拓品牌客户并扩大市场份额，进一步强化经营管理水平，提高研发效率、优化产品结构和成本管控，从而提高持续经营能力，并做好相关信息披露工作，切实维护投资者利益；提请投资者特别关注上述事项引致的相关风险。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）技术风险

1、技术迭代的风险

射频前端芯片涵盖功率放大器、滤波器、开关、低噪声放大器等多个复杂子模块，需要深厚的无线通信技术以及集成电路设计经验。5G 及未来通信技术的发展，对芯片的性能、集成度、功耗、尺寸等提出了更高要求，如要支持更高频率、更大带宽，设计研发难度大。公司产品需要随着不断发展的通信技术进行迭代，目前已经推出 4G、5G（6GHz 以下频段）等射频前端产品，但若公司无法持续推出满足新一代通信技术要求的产品，有可能面临技术淘汰的风险。此外，同代通信技术内也存在射频前端方案不断迭代、市场格局快速演变的情形，这要求射频前端厂商持续跟进最新射频前端方案，不断优化提升产品性能，实现产品迭代，满足客户的多样化需求。若公司的技术升级速度和产品迭代成果未达到预期水平，未能及时有效满足市场需求，则可能面临公司产品被替代或淘汰，新一代产品无法获得足够市场份额和定价权的风险。

2、核心技术人才储备不足及人才流失的风险

半导体行业是典型的技术和人才密集型行业，尤其公司采用 Fabless 的经营模式，技术人才是公司的核心资产之一。随着公司规模快速扩大，产品线不断丰富，公司需要进一步吸纳优秀的技术人才，丰富公司技术团队的覆盖领域，形成优势互补、相互协作的团队配置。然而，射频芯片领域进入门槛较高，需要长期积累研发经验，优秀的研发人员较为稀缺；同时由于市场规模大、发展前景良好，射频芯片领域吸引了大量新的市场参与者进入，企业对人才的争夺日趋激烈。若公司缺乏对人才的吸引力，或者未能建立起对人才的有效激励体系，将难以引进更多的高端技术人才，甚至可能面临现有骨干技术人才流失的风险，进而对公

司技术研发产生不利影响。

3、研发失败的风险

公司自成立以来专注于底层技术架构创新，基于绝缘硅材料（SOI）和砷化镓材料（GaAs）的混合架构推出了可重构射频前端方案并成功商用，该技术架构亦需随着技术迭代不断升级并向更多的产品线拓展，以达到新技术的性能要求。随着智能手机、物联网等应用领域对射频前端芯片的需求不断变化，同时新产品研发周期长，若公司研发方向与市场需求不匹配，或不能及时响应市场变化，可能导致研发的新产品不适应未来市场需求的发展变化。若公司对自身技术开发能力判断失误、在研发过程中关键技术未能突破，有可能导致公司的核心技术架构无法适应最新的技术发展趋势，或者导致公司新产品无法满足客户需求、获得客户认同，公司的产品销售被延迟或无法顺利销售，公司将面临研发失败风险，导致前期研发投入无法收回，对公司持续发展和市场竞争力造成不利影响。

4、核心技术泄露的风险

长期以来公司以技术创新作为驱动力，自主研发了射频前端领域的核心技术，从而获得市场竞争优势。为避免核心技术泄露，保障经营过程中所积累的专利、IP 及技术的安全性，公司建立了较为完善的保密体系，例如与员工签署保密及竞业禁止相关协议、规范化研发流程管理以及申请集成电路布图设计专有权及发明专利保护等。

然而，上述体系不能完全排除因个别技术人员违反职业操守而泄密或者公司内控制度出现技术漏洞的情况，一旦核心技术泄密，可能给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

（二）经营风险

1、尚未盈利的风险

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-13,668.65 万元，尚未实现盈利。主要原因系：由于行业竞争日益激烈，射频前端厂商面临较大的价格下行压力，产品毛利空间受到挤压；上年同期确认较多与收益相关的政府补助，本期政府补助同比较少；同时本期计提的存货跌价准备有所增加。

由于公司所处的射频前端芯片设计行业具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入大等特点，在未来可预见的期间内，公司将会继续保持较大的研发投入。如

公司未能按计划实现销售规模的扩张，或产品的总体市场需求大幅度下滑，公司的营业收入可能无法达到预计规模，无法充分发挥其经营的规模效应，或者市场竞争继续加剧导致公司的毛利空间被进一步压缩，盈利水平可能无法完全覆盖公司研发投入等各项支出，存在未来一定期间内仍无法盈利且持续存在未弥补亏损的风险。

2、头部客户拓展不及预期，营业收入无法持续增长的风险

目前，公司正在积极拓展国内外一线品牌终端客户，持续深化与该等头部客户的合作关系。但是射频前端产品验证周期较长，产品需求紧跟射频前端方案的最新演进趋势，市场开拓的周期、成效也受到客户整体战略规划、市场偏好及竞争对手等多重因素的影响，若公司未能准确把握下游客户的应用需求，主要产品在终端客户中验证失败或者导入进度不及预期，将导致客户开拓进展低于预期或者客户拓展失败或者现有客户关系发生不利变化的风险，公司将无法在头部品牌终端客户中提升销售份额或丧失当前的有利地位，进而对公司持续竞争力、成长性及未来经营业绩产生不利影响。

3、公司业务规模和行业龙头存在较大差距的风险

目前全球射频前端市场仍由 Skyworks、Qorvo、Broadcom、Qualcomm 和 Murata 等美系和日系厂商占据主导地位，且该等国际龙头厂商具有深厚的技术积累和强大的资金实力，每年均投入巨额的研发费用以维持其产品竞争力，保持其相对领先的市场地位。国产射频前端厂商中卓胜微、唯捷创芯、昂瑞微 2026 年半年度报告显示，2026 年半年度营业收入分别为 18.10 亿元、9.74 亿元和 7.73 亿元，公司与国内主要竞争对手相比具有一定的规模劣势。

4、委外生产模式的风险

公司采用行业通行的 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发、设计和销售环节，将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。

尽管 Fabless 经营模式已经成为行业惯例，但是若上游晶圆代工厂、基板代工厂、封测代工厂出现工艺变更，可能导致公司需要切换新的代工厂或重新进行新工艺磨合，需要消耗较长的时间，从而影响公司经营稳定性；此外，若发生晶圆代工厂、基板代工厂、封测代工厂等产能短缺、产品提价或其他突发性风险，可能导致公司无法获得足够的产能支持或采购成本上升，从而对公司日常经营和盈利能力造成不利影响。

5、供应商集中度较高的风险

公司的供应商主要包括晶圆代工厂、基板代工厂和封测代工厂等。一方面，由于上述代工行业资本投入大、技术门槛高，行业集中度较高，且公司主要采用的绝缘硅和砷化镓材料相关工艺为特殊工艺，晶圆代工产能供应规模明显小于传统的体硅 CMOS 工艺，能够满足公司技术及生产需求的晶圆制造及封测供应商数量有限；另一方面，由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛高，芯片设计公司出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别代工厂进行合作，因此公司的上游供应商集中度较高。

目前公司与主要供应商均保持稳定的合作关系。若公司的主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，或由于其他不可抗力因素不能与公司继续进行业务合作，可能影响公司产品的正常生产和交付进度，对公司生产经营产生不利影响。

6、产品质量风险

公司的射频前端模组产品主要用于无线通信的信号发射或接收，直接影响智能终端的信号收发质量，在终端应用中具有举足轻重的作用，客户对公司产品的质量及可靠性要求较高。公司与全球领先的代工厂合作，而且产品在成品入库前均会进行较为严格的品质测试，保证了较高的质量标准。但若未来公司在产品持续升级迭代、新产品开发过程中不能达到客户质量标准，或上游供应商提供的产品或者服务出现质量及可靠性问题，可能损害公司的品牌声誉，对公司与下游客户的合作产生不利影响。

（三）财务风险

1、毛利率波动的风险

公司的产品包括 5G 模组、4G 模组，主要应用于手机和物联网领域。产品毛利率水平主要受产品结构、产品售价与成本等因素综合影响。公司产品销售单价受市场供求关系、同行业厂商竞争策略、产品及技术的先进性、产品更新迭代、终端客户议价能力、过往销售价格以及公司的战略布局等因素的共同影响；产品单位成本亦受原材料及封测服务的采购单价以及产业链供需关系等因素影响，均存在一定的不确定性。若公司未能正确判断下游需求变化或者公司技术实力未跟上市场需求变化，未能根据市场需求及时迭代升级现有产品或推出符合市场趋势

的新产品，或者因公司产品市场竞争格局发生变化、抢占市场份额导致销售价格持续下降，或者未来原材料或封装测试服务产能供给紧张导致采购价格上涨，公司不能有效控制产品成本，均可能导致公司毛利率水平波动甚至下降、或者未来提升不及预期的风险，对公司盈利能力产生不利影响。

2、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、库存商品、委托加工物资及在途物资构成。报告期末，公司存货账面价值为 66,029.27 万元，占流动资产的比例为 35.34%。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货绝对金额随之上升。若公司无法准确预测市场需求和管控存货规模，则可能面临因市场环境发生变化而导致的存货跌价的风险。

3、经营活动现金流量净额为负的风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-24,096.74 万元，主要原因系公司经营活动尚未盈利，销售商品产生的现金流入不足以覆盖支付货款及各项费用的现金流出。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，且公司未能通过其他渠道筹集资金补充营运资金，将对公司的经营发展产生不利影响。

4、税收优惠政策变动的风险

截至目前，公司享受有高新技术企业所得税优惠，如果未来公司无法满足税收优惠政策要求或税收优惠政策发生变化，可能对公司的盈利状况产生一定影响。

5、汇率波动的风险

报告期内，公司存在大量的境外销售和境外采购，并且以美元进行结算。随着公司业务的持续扩张，境外采购和境外销售金额预计将会进一步增加，且公司在晶圆采购、委外生产、产品销售回款等环节存在一定的时间差。虽然公司在业务开展时已考虑了合同/订单及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内外政治、经济环境发生变化，美元兑人民币的汇率变动将存在较大不确定性，公司将面临汇率波动的风险，将对公司业绩造成一定影响。

6、政府补助波动的风险

公司获得的政府补助主要与公司承担的相关科研项目、产业政策扶持等相关，其取得具有较大的政策导向性和不确定性，受相关政策的调整、项目评审及验收结果等因素影响。

公司政府补助属于非经常性损益，不具备持续性和稳定性，不能代表公司主营业务盈利能力。若未来公司获得政府补助的金额大幅下降或无法持续取得，将导致公司扣除非经常性损益后的亏损进一步扩大，对公司经营业绩产生不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争的风险

目前，全球射频前端市场仍由 Skyworks、Qorvo、Broadcom、Qualcomm、村田等美系和日系厂商占据主导地位，且该等国际龙头厂商具有较为深厚的技术积累和较为强大的资金实力，每年均投入巨额的研发费用以维持其产品竞争力，保持其相对领先的市场地位。同时，受益于产业政策和下游终端应用国产化推动，国内射频前端行业正快速发展，良好的行业前景吸引了更多的资金资源参与行业竞争，原有厂商在夯实自身竞争优势基础上积极开拓市场，公司所处行业竞争日趋激烈。

在此背景下，一方面，如果竞争对手持续采用低价竞争等策略激化市场竞争形势，可能对公司产品的销售收入和利润率产生不利影响；另一方面，如果公司不能准确把握市场动态和行业发展趋势，提升技术实力，顺应下游的需求持续更新迭代，扩大销售规模，则公司目前取得的市场份额可能被其他竞争对手挤占，进而使得公司的行业地位、市场份额、经营业绩受到不利影响。

2、产业政策变化的风险

半导体行业是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体行业的发展，增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司的经营情况将会面临更多的挑战，可能对公司业绩产生不利影响。

3、原材料及代工价格波动的风险

由于受到宏观经济环境变化的影响，全球半导体及集成电路市场存在一定的周期性波动，公司主要采购晶圆、基板等产品及封测服务的价格也随之存在起伏。目前，公司凭借自身的市场竞争力、长期的合作关系等方式维持供应链的稳定性。未来如果上游产能紧张的形势加剧导致价格上升，或者公司不能有效应对晶圆、基板、封测服务等采购价格上涨的影响，将会对公司的盈利能力、产品供应的稳定性造成不利影响。

4、终端手机等消费电子出货量下滑的风险

2026 年以来，受存储芯片供给紧张及价格上涨影响，手机厂商面临成本上升和出货节奏调整压力。若未来存储芯片等关键零部件供给紧张及价格上涨持续，可能进一步推高智能手机整机成本，导致终端厂商下调生产计划、延后新品发布或压缩部分机型出货规模。公司产品目前仍主要应用于智能手机等移动终端领域，若全球及中国智能手机市场需求下滑或恢复不及预期，或下游客户因成本压力调整采购节奏，可能对公司相关产品订单释放、收入增长及经营业绩产生一定不利影响。

（五）宏观环境风险

1、国际贸易摩擦风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级，集成电路产业成为贸易冲突的重点领域，有关国家针对半导体设备、材料和技术等相关领域颁布了一系列针对中国的出口管制政策。集成电路是高度全球化的产业，如果国际贸易摩擦进一步加剧，从上游供应链来看，公司主要晶圆代工厂、EDA 软件供应商系境外企业，可能因为国际贸易政策的因素对公司相关采购产生不利影响；从下游应用领域来看，公司客户可能会因为贸易摩擦受到不利影响，进而影响到公司向其销售各类产品，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

（六）其他重大风险

1、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，涉及专利、集成电路布图设计和软件著作权等众多知识产权。公司通过申请专利、与员工签署保密及竞业禁止相关协议等方式对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司持续经营具有重要意义，但无法排除关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，避免侵犯他人知识产权，但无法避免竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略，从而阻碍公司正常业务发展，也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能。此外，虽然公司已经在境外拥有注册专利，但是仍可能因国别和法律体系的不同导致对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解各国知识产权保护法律的内涵和规定，也

可能会因此在其他国家引发争议和诉讼的风险。

2、技术授权风险

公司技术和产品研发的过程中需要使用电子设计自动化软件（EDA），并取得相关 EDA 供应商的技术授权。集成电路芯片设计行业中，EDA 市场目前形成了寡头竞争的格局，主要国外厂商的 EDA 工具在其细分功能领域没有可靠的替代性产品。如果 EDA 供应商取消对公司技术授权，将可能导致研发和生产活动无法正常开展，对公司业务和经营产生重大不利影响。

3、内控风险

（1）实际控制人持股比例较低导致控制权变化的风险

截至本报告期末，实际控制人李阳、郭耀辉合计控制公司的表决权比例为 28.91%。虽然李阳、郭耀辉及其实际控制的主体、一致行动人奕江涛、王国样所持股份尚处于限售期，但公司实际控制人控制股权比例较低，存在公司控制权不稳定的风险，可能会对公司业务开展和经营管理的稳定产生不利影响。

（2）经营规模发展迅速而导致的管理风险

随着未来公司业务持续发展和募投项目的实施，公司的收入、资产规模预计将进一步扩大，员工人数也将相应增加，将对公司的经营管理、产品研发、质量管控、市场开拓和内部控制等方面提出更高的要求。

如果公司的组织模式、管理制度和运营水平未能随业务规模扩大及时优化及提升，将使公司一定程度上面临生产经营效率降低的管理风险，进而对公司的持续发展造成不利影响。

（3）内控体系建设及内控制度执行的风险

公司根据现代企业管理的要求，已经建立了符合科创板上市公司要求的内部控制体系，但上述制度及体系的实施时间较短，仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善。若公司有关内部控制制度不能有效贯彻和落实，将直接影响公司生产经营活动的合规性以及运行效率，进而影响公司经营管理目标的实现。

三、重大违规事项

在本持续督导期内，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，公司主要财务数据及指标情况如下：

单位：万元

主要财务数据	2026年1-6月/ 2026 年 6 月 30 日	2025年1-6月/ 2025 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
营业收入	46,846.48	35,451.63	32.14
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	46,846.48	35,451.63	32.14
归属于上市公司股东的净利润	-13,668.65	-6,527.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,553.71	-13,735.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,096.74	-23,539.52	不适用
归属于上市公司股东的净资产	153,139.21	164,055.74	-6.65
总资产	220,044.11	193,351.96	13.80
基本每股收益（元 / 股）	-0.29	-0.14	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.29	-0.14	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.31	-0.30	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-8.64	-3.65	减少 4.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.20	-7.68	减少 1.52 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	21.42	28.02	减少 6.60 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、2026 年上半年公司营业收入为 46,846.48 万元，较上年同期增长 32.14%，主要原因系报告期内公司产品结构不断优化，国内头部品牌客户和海外客户出货量稳步提升，推动公司营业收入实现增长。

2、2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为-13,668.65 万元，净亏损较上年同期增加 109.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,553.71 万元，净亏损较上年同期增加 5.96%，主要原因系上年同期确认较多与收益相关的政府补助，本期政府补助同比减少；同时基于谨慎性原则，本期计提的存货跌价准备有所增加。

3、2026 年上半年末，归属于上市公司股东的净资产同比下降 6.65%，主要原因系本期净亏损增加。

4、2026 年上半年，公司基本每股收益、稀释每股收益为-0.29 元/股，每股亏损较上年同期增加 106.63%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.31 元/股，每股亏损较上年同期增加 3.33%；加权平均净资产收益率为-8.64%，较上年同期减少 4.99 个百分点；主要原因系去年同期确认的与收益相关的政府补助较多，本期政府补助同比减少，使得公司本期净亏损同比扩大，进而导致每股亏损增加。

5、2026 年上半年，公司研发投入占营业收入的比例为 21.42%，较上年同期减少 6.60 个百分点，主要原因系本期销售规模扩大，研发投入占比下降。

五、核心竞争力的变化情况

慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端芯片的设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。

射频前端芯片作为无线通信设备的核心器件，负责保障信号的发射和接收。公司产品系列覆盖 2G、3G、4G、3GHz 以下的 5G 重耕频段、3GHz~6GHz 的 5G UHB 等蜂窝通信频段和 Wi-Fi 通信等，可为客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等。

2026 年上半年，公司聚焦射频前端芯片核心主业，以技术创新构筑核心竞争壁垒，产品结构不断优化，国内头部品牌客户和海外客户出货量稳步提升，推动公司营业收入同比增长 32.14%。公司深耕射频前端领域，坚持以技术创新为核心竞争优势，不断提升产品性能、积极拓展品牌客户，丰富射频前端产品品类；同时持续提高管理效率，优化产品结构和成本管控，努力提升经营水平，以保证未来的持续发展及竞争力提升。

综上所述，2026 年上半年公司核心竞争力未发生重大不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

2026 年上半年，公司研发投入为 10,034.34 万元，较上年同比增加 1.03%，研发投入占营业收入的比例为 21.42%，较上年同期减少 6.60 个百分点，主要原因系本期销售规模扩大，研发投入占比下降。

公司作为技术型企业，研发方向高度重视客户需求和行业技术发展趋势。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计拥有 186 项发明专利、25 项实用新型专利、180

项集成电路布图设计专有权。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-58号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
一、募集资金总额	113,596.65
减：直接支付发行费用	10,763.76
二、募集资金净额	102,832.89
减：	
以前年度已使用金额	90,860.79
本年度使用金额	5,217.17
累计银行手续费支出及汇兑损益	4.28
加：	
累计募集资金利息收入	2,065.74
三、2026年6月30日募集资金余额	8,816.39

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月10日

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
账户名称	开户银行	银行账号	2026 年 6 月 30 日余额	账户状态
广州慧智微电子股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000109898368	8,019.10	使用中
广州慧智微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907293110609	781.48	使用中
广州慧智微电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	82210078801300002219	-	已注销
尚睿微电子（广州）有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120921148710909	-	使用中
尚睿微电子（上海）有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120915245810906	15.80	使用中
合计			8,816.39	

公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，慧智微控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)	合计持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	李阳	董事长、总经理、核心技术人员	3,643.12	993.44	4,636.56	9.93
2	郭耀辉	董事、副总经理	2,057.99	688.97	2,746.96	5.88
3	江翰博	董事	-	-	-	-
4	洪昀	独立董事	-	-	-	-
5	李斌	独立董事	-	-	-	-
6	朱晓磊	职工代表董事	-	13.60	13.60	0.03

7	徐斌	财务总监、 董事会秘书	25.20	210.00	235.20	0.50
---	----	----------------	-------	--------	--------	------

公司控股股东、实际控制人为李阳和郭耀辉。2026 年 6 月末，李阳、郭耀辉合计直接持有公司 12.21%的股份，通过慧智慧资、横琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、横琴智往、横琴智今、横琴智来等持股平台控制公司 14.24%的表决权，同时通过与奕江涛、王国样的一致行动关系控制公司 2.45%的表决权，因此李阳、郭耀辉合计控制公司的表决权比例为 28.91%。

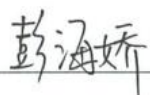
截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州慧智微电子股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



彭海娇



张 辉

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2026 年 9 月 1 日

